



Descripción del Producto

El adhesivo **TEKBOND 198** es un sellador químico anaeróbico tixotrópico, de alta viscosidad, resistencia mediana al desarmado y alta resistencia a la presión. Después de aplicado, impide la corrosión y las fugas entre las conexiones metálicas.

Se recomienda principalmente para la unión y el sellado de bridas metálicas rígidas, tapas de motores, cajas de engranajes, pudiendo ser utilizadas también en bridas de aluminio que necesiten buena resistencia química.

Propiedades Físicas - Líquido

Apariencia (visual):	Líquido rojo (GEL)
Viscosidad a 25°C:	500,000 –1,000,000 cps
Densidad a 25°C:	1.09–1.11 g/ml
Punto de inflamación (TCC):	>93°C
Tiempo de almacenamiento a 20°C:	18 meses
Curado inicial:	≤ 300 minutos
Curado total:	24 horas

Propiedades Físicas - Curado

Apariencia (visual):	Sólido rojo
Temperatura de operación:	-60 a 150°C
Rellenado de holgura:	0.25 mm
Resistencia a la presión N/mm² (PSI):	≥ 35 (≥ 5.000)

Instrucciones de uso y manejo

1. Para un mejor desempeño, las superficies deben estar limpias, libres de grasa y suciedad.
2. Para materiales inactivos como acero inoxidable, aluminio, hierro fundido y zamac recomendamos el uso del **Activador T**: Acelerador del curado para los adhesivos anaeróbicos (activa y limpia superficies metálicas o inertes).
3. Aplicar el adhesivo en el lugar que se desea pegar, esparciendo uniformemente en forma de filete continuo en una de las superficies de la brida.
4. Arme las piezas y apriete los encastres hasta obtener la alineación apropiada.
5. Los encastres deben ser apretados lo más rápido posible para que no haya formación de calzas.

6. El desarmado de las piezas como, por ejemplo, uniones bridadas, se puede hacer con herramientas manuales. Las piezas pueden ser reutilizadas retirando los residuos con un cepillo apropiado y reaplicando el sellador 198 en el lugar deseado.

Nota: Los adhesivos anaeróbicos curan en ausencia de aire y entre las partes metálicas, el exceso de adhesivo puede ser retirado con un paño.

Instrucciones de almacenamiento

Mantenga fuera del alcance de los niños. Mantener en lugar fresco a una temperatura de 15 a 25°C, lejos de metales y productos químicos.

Informaciones generales

No utilizar para el sellado de líneas de oxígeno líquido, en altas concentraciones de cloro o en materiales fuertemente oxidantes, porque puede haber explosiones. No es recomendado para plásticos. En caso de contacto con la piel y los ojos lave con agua en abundancia.

Para mayores informaciones y el manejo seguro de este producto consulte la **FISPQ** – Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos.

Envases disponibles

Tekbond ofrece envases de:

- ✓ 15g (SGA: 69957326963)
- ✓ 50g (SGA: 69957326970)
- ✓ 250g.

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.